

行业月度报告

半导体

景气延续，关注扩产周期下的半导体设备企业

2021年06月21日

评级 领先大市

评级变动：首次

行业涨跌幅比较



%	1M	3M	12M
半导体	5.88	19.14	24.18
沪深300	3.64	6.27	29.82

何晨 分析师
执业证书编号: S0530513080001
hechen@cfzq.com
0731-84779574

张看 研究助理
zhangkan@cfzq.com

相关报告

重点股票	2020A		2021E		2022E		评级
	EPS	PE	EPS	PE	EPS	PE	
士兰微	0.05	485.25	0.61	83.61	0.76	66.71	推荐
扬杰科技	0.8	55.44	1.14	46.12	1.39	37.76	谨慎推荐
长电科技	0.81	52.31	1.01	34.9	1.29	27.48	谨慎推荐
北方华创	1.08	167.12	1.46	174.9	2.02	126.73	谨慎推荐
精测电子	0.99	55.72	1.53	37.82	2.01	28.66	谨慎推荐
闻泰科技	1.94	51.01	3.01	33.54	4.08	24.76	推荐
华峰测控	3.26	114.74	4.99	85.53	6.88	62.02	谨慎推荐

资料来源：财信证券

投资要点：

- **市场行情回顾：**2021年5月1日至6月17日，申万半导体指数涨跌幅为16.48%，优于各大指数。各细分子板块中半导体材料以区间涨幅为33.95%领涨。从整体估值水平来看，申万半导体板块整体法估值PE为90.48倍，估值处于历史前25.90%分位；中位数法估值PE为94.87倍，估值处于历史前31.80%分位。
- **需求端：**三月份开始国内市场手机出货量连续3个月环比下滑，出货量出现快速回落；国外方面，疫情反复对具有需求弹性的印度市场产生负面影响，手机厂商相继下调出货量，而过去消费者对电子产品价格只跌不涨的价格观念考验手机终端传导原材料上涨的有效性；受益于在线需求提升的PC与服务器尽管受到缺料的影响，但订单表现依旧强劲，并增补手机终端出口的代工产能，在部分地区疫情反复与缺芯限制下，后续变化有待进一步跟踪。
- **供给端：**晶圆代工端产能维持高水平运转，并相继取消折扣并提高晶圆报价，其中成熟制程为主的联电、力积电和旺宏月度营收逐步反应涨价效应。整体封测厂商月度营收呈现逐月爬坡态势，其中DRAM/NAND/驱动IC等封装订单表现强劲，但考虑到此轮需求失衡的产品以打线封装、基板封装为主，受上游晶圆产能约束和自身议价能力影响，封测端价格传导强度与时间弱于晶圆代工。
- **设备端：**以台积电为代表，代工厂相继上调资本开支，在资本开支与设备供应约束下，先进制程处于寡头垄断的态势，其余晶圆代工厂将支出重点开向成熟制程，8寸晶圆扩产又以国内为主，北美半导体设备出货额与日本半导体设备出货额于4月份延续高增长。
- **投资建议：**给予行业“领先大市”评级，建议关注景气上行且在此轮行情中具有显著优势的IDM厂商士兰微、闻泰科技和扬杰科技；封测厂商长电科技；半导体设备商：北方华创、精测电子和华峰测控。
- **风险提示：**贸易摩擦加剧，需求不及预期，国产替代放缓。

内容目录

1 投资建议	4
2 市场行情回顾	4
3 行业数据与观点汇总	6
3.1 半导体设备出货量显著提升，国内扩产意愿积极.....	6
3.2 产业资本开支大幅上修，成熟制程为主要扩产动力.....	7
3.3 台股月度经营数据延续景气，部分涨价动能体现.....	8
4 行业重点新闻	10
4.1 SEMI：2022 年全球半导体产业规模均值达 5700 亿美元，至 2022 年进入三年超级周期.....	10
4.2 刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议.....	10
4.3 一季度十大晶圆代工厂商产值再创新高.....	11
5 重点公司新闻	11
5.1 中芯国际（688981.SH）：推出股权激励计划，员工覆盖范围广.....	11
5.2 长电科技（600584.SH）：完成收购 ADI 新加坡测试工厂.....	11
5.3 华润微（688396.SH）：拟与大基金共建 12 寸功率半导体晶圆生产线.....	12
5.4 士兰微（600460.SH）：拟 12 英寸高压集成电路和功率器件芯片.....	12
6 风险提示	12

图表目录

图 1：2021 年 5 月 1 日至 6 月 17 日申万半导体指数表现.....	5
图 2：2021 年 5 月 1 日至 6 月 17 日申万电子各子板块指数表现.....	5
图 3：截止 2021 年 6 月 17 日申万半导体板块整体法 PE.....	6
图 4：截止 2021 年 6 月 17 日申万半导体板块中值法 PE.....	6
图 5：全球半导体销售额月度数据变化.....	6
图 6：中国半导体销售额月度数据变化.....	6
图 7：全球半导体设备和材料销售额季度数据变化.....	7
图 8：中国大陆半导体设备和材料销售额季度数据变化.....	7
图 9：北美半导体设备制造商月度出货额与同比变动.....	7
图 10：日本半导体设备制造商月度出货额与同比变动.....	7
图 11：主要晶圆代工厂资本开支变化.....	8
图 12：各主要晶圆厂 2021 年资本开支变化.....	8
图 13：台股 IC 设计月度营收变动与同比增速.....	8
图 14：联发科月度营收变动与同比增速.....	8
图 15：联咏月度营收变动与同比增速.....	9
图 16：瑞昱月度营收变动与同比增速.....	9
图 17：台积电月度营收变动与环比增速.....	9
图 18：联电月度营收变动与环比增速.....	9
图 19：力积电月度营收变动与环比增速.....	9
图 20：旺宏月度营收变动与环比增速.....	9
图 21：台股 IC 封装测试月度营收变动与同比增速.....	10

图 22: 日月光投控月度营收变动与同比增速..... 10

表 1: 2021 年 5 月 1 日-6 月 17 日申万半导体行业涨跌幅前五名..... 5

1 投资建议

【需求端】部分地区疫情与缺芯限制导致下游需求存不确定性。三月份开始国内市场手机出货量连续 3 个月环比下滑，由于一季度后进入主要品牌商机型发布的真空期，同时高端市场未能充分承接华为出让的份额，出货量出现快速回落；国外方面，疫情反复对具有需求弹性的印度市场产生负面影响，手机厂商相继下调出货量，而过去消费者对电子产品价格只跌不涨的价格观念考验手机终端传导原材料上涨的有效性；受益于在线需求提升的 PC 与服务器尽管受到缺料的影响，但订单表现依旧强劲，并增补手机终端出让的代工产能，在部分地区疫情反复与缺芯限制下，后续变化有待进一步跟踪。

【供给端】产能利用率维持高水位，疫情局部反复加剧行业供给不确定性。晶圆代工产能维持高水平运转，主要代工厂产能利用率超过 95%，并相继取消折扣并提高晶圆报价，其中成熟制程为主的联电、力积电和旺宏月度营收逐步反应涨价效应。台股整体封测厂商月度营收呈现逐月爬坡态势，其中 DRAM/NAND/驱动 IC 等封装受益于下游需求旺盛以及积极备货影响订单表现强劲，但考虑到此轮需求失衡的产品以打线封装、基板封装为主，原材料成本占比较高；技术相对成熟，客户的选择性更多；封测厂传统封装利润率维持高位，因此受上游晶圆产能约束和自身议价能力影响，封测端价格传导强度与时间弱于晶圆代工。

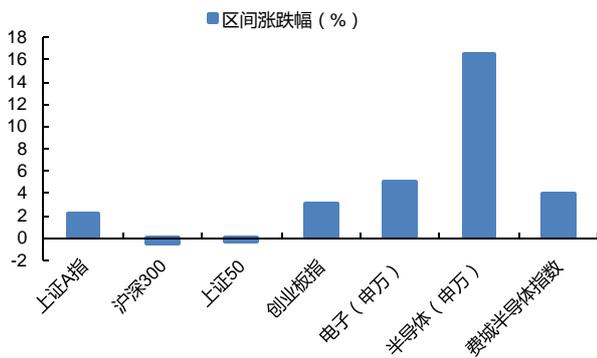
【设备端】半导体设备企业将持续受益于资本开支的超级周期。以台积电为代表，代工厂相继上修资本开支，在资本开支与设备供应约束下，先进制程处于寡头垄断的态势，其余晶圆代工厂将支出重点开向成熟制程，8 寸晶圆扩产又以国内为主，北美半导体设备出货额与日本半导体设备出货额于 4 月份延续高增长，其中 4 月份日本半导体设备出货额增速或暗示半导体设备资本开支由前道晶圆制造环节向后道封测环节蔓延。

【投资建议】给予行业“领先大市”评级，建议关注景气上行且在此轮行情中具有显著优势的 IDM 厂商士兰微、华润微和扬杰科技；封测厂商长电科技；半导体设备商：北方华创、精测电子和华峰测控。

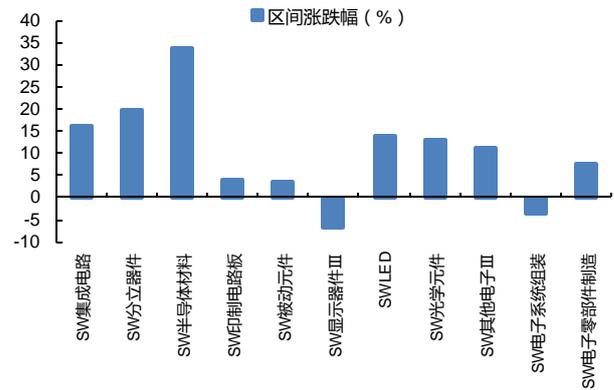
2 市场行情回顾

2021 年 5 月 1 日至 6 月 17 日，申万半导体指数涨跌幅为 16.48%，同期上证 A 指、沪深 300 指数、上证 50 指数和创业板指数涨跌幅分别为 2.28%、-0.42%、-0.27% 和 3.14%，半导体板块涨幅较大，表现优于各大指数。

各细分子板块方面，半导体材料、分立器件、集成电路、LED 和光学元件涨幅靠前，其中半导体材料受消息面提振，区间涨幅为 33.95%；电子系统组装和显示器件收跌。

图 1：2021 年 5 月 1 日至 6 月 17 日申万半导体指数表现


资料来源：Wind，财信证券

图 2：2021 年 5 月 1 日至 6 月 17 日申万电子各子板块指数表现


资料来源：Wind，财信证券

从个股情况来看，2021 年 5 月-6 月 17 日申万半导体行业上涨家数 43 家，下跌家数 3 家，涨跌幅中位数为 24.92%，剔除上市不足一年的新股后申万通信行业涨幅排名前五的股票为国民技术 (+139.46%)、瑞芯微 (+70.93%)、全志科技 (+70.06%)、富满电子 (+69.76%) 和北方华创 (+52.09%)。封测企业如晶方科技 (-3.49%)、长电科技 (-2.74%)、通富微电 (+2.95%) 和华天科技 (+6.33%) 涨幅靠后。

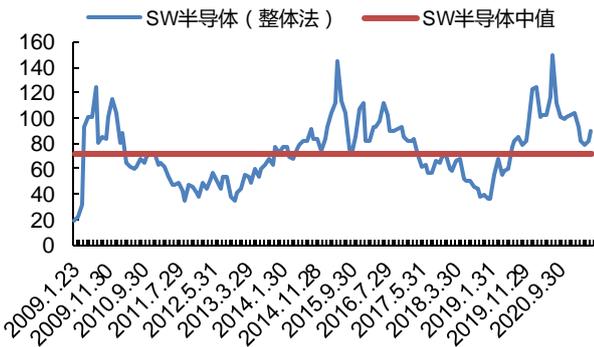
表 1：2021 年 5 月 1 日-6 月 17 日申万半导体行业涨跌幅前五名

行业涨幅前五名			行业跌幅前五名		
代码	名称	涨幅	代码	名称	涨幅
300077.SZ	国民技术	139.46%	603005.SH	晶方科技	-3.49%
603893.SH	瑞芯微	70.93%	600584.SH	长电科技	-2.74%
300458.SZ	全志科技	70.06%	603501.SH	韦尔股份	-2.04%
300671.SZ	富满电子	69.76%	002156.SZ	通富微电	2.95%
002371.SZ	北方华创	52.09%	002185.SZ	华天科技	6.33%

资料来源：wind，财信证券

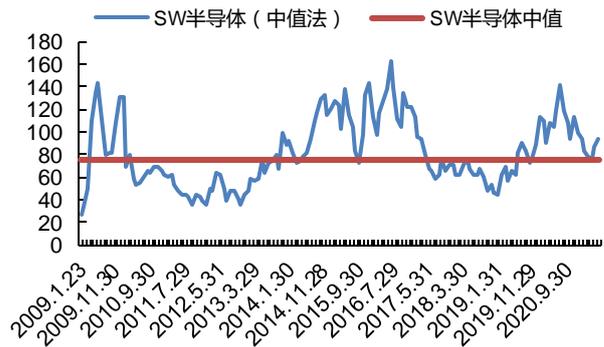
从整体估值水平来看，申万半导体板块整体法估值 PE (TTM，剔除负值) 为 90.48 倍，估值处于历史前 25.90% 分位，自 2009 年起整体法的估值中位数为 71.84 倍；申万半导体中值法估值 PE (TTM，剔除负值) 为 94.87 倍，估值处于历史前 31.80% 分位，自 2009 年起中值法的估值中位数为 75.88 倍。

图 3: 截止 2021 年 6 月 17 日申万半导体板块整体法 PE



资料来源: Wind, 财信证券

图 4: 截止 2021 年 6 月 17 日申万半导体板块中值法 PE



资料来源: Wind, 财信证券

3 行业数据与观点汇总

3.1 半导体设备出货量显著提升，国内扩产意愿积极

根据 SIA 数据，2021 年 4 月全球半导体销售额为 418.5 亿美元，同比增长 22%，其中中国半导体销售额达到 148 亿美元，同比增长 26%，在需求与涨价的双重推动下，半导体月度销售规模双双创下历史新高，而作为需求与产业供应率先从疫情恢复的中国，其销售额占全球半导体销售额在 4 月份提升至 35.36%。

设备端表现更为明显，2021 年一季度全球半导体设备销售额达到创纪录的 235.7 亿美元，同比增长 70.92%，其中中国大陆半导体设备销售额录得 59.6 亿美元，同比增长 152.54%，半导体设备销售额占比约为 25.29%，国内扩产意愿强烈。在半导体设备领域，美国、日本与荷兰占据绝大部分半导体制造市场份额，从月度数据上，北美半导体设备出货额与日本半导体设备出货额于 4 月份延续高增长，分别为 34.10 亿美元和 282.05 亿日元(2.56 亿美元)，其中 4 月份日本半导体设备出货额同比增长 35.52%，环比增长 17.18%，连续两月同环比保持双位数增长，考虑主要封测设备提供商 Advantest、Screen 和 Disco 均位于日本，或暗示半导体设备资本开支由前道晶圆制造环节向后道封测环节传导。

图 5: 全球半导体销售额月度数据变化



资料来源: SIA, Wind, 财信证券

图 6: 中国半导体销售额月度数据变化



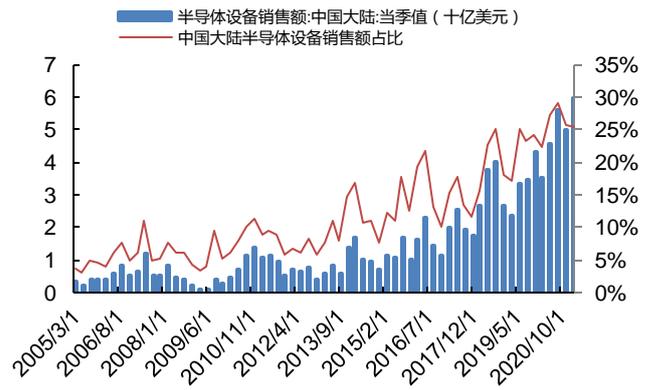
资料来源: SIA, Wind, 财信证券

图 7：全球半导体设备和材料销售额季度数据变化



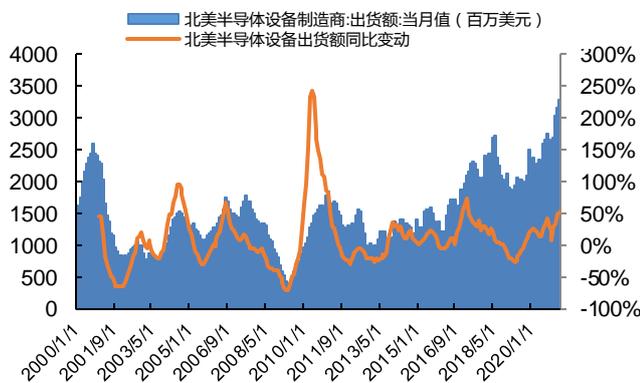
资料来源：Wind，财信证券

图 8：中国大陆半导体设备和材料销售额季度数据变化



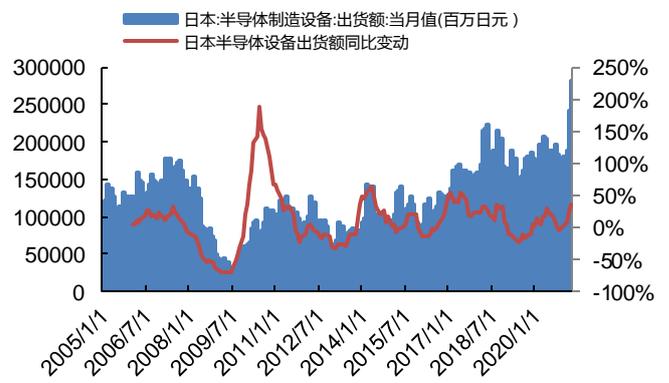
资料来源：Wind，财信证券

图 9：北美半导体设备制造商月度出货额与同比变动



资料来源：Wind，财信证券

图 10：日本半导体设备制造商月度出货额与同比变动

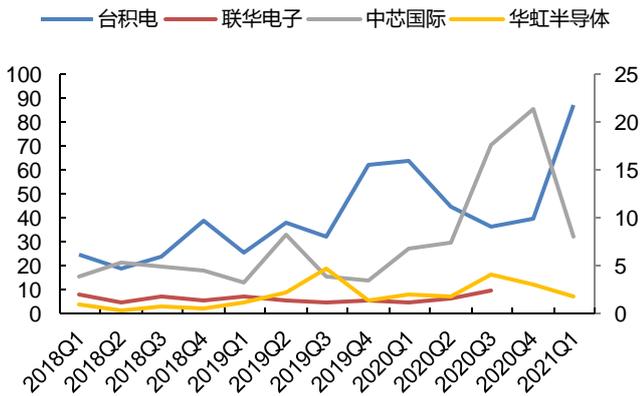


资料来源：Wind，财信证券

3.2 产业资本开支大幅上修，成熟制程为主要扩产动力

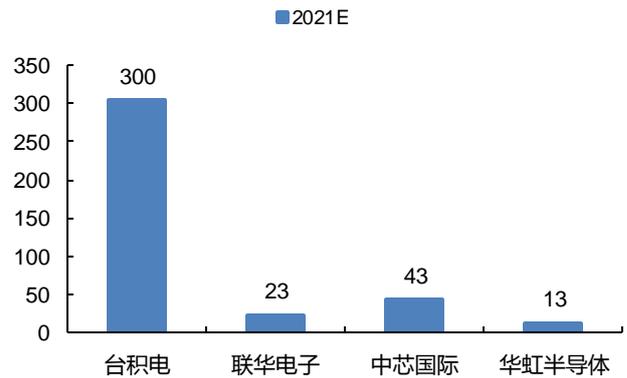
2021 年一季度，台积电率先吹响扩产号角，2021Q1 台积电资本开支高达 87.11 亿美元，同比增长 36.40%，并将 2021 年资本开支逐步上调至 300 亿美元左右，未来三年资本开支合计 1000 亿美元，其中 2021 年资本开支中 80% 将用于先进的工艺技术，包括 3/5/7nm 节点，大约 10% 将用于先进封装和光罩，大约 10% 将用于成熟制程；中芯国际维持 43 亿美元资本开支不变，其中大部分用于成熟制程，小部分用于先进制程。目前在资本开支与设备供应约束下，先进制程基本处于寡头垄断的态势，其余晶圆代工厂将支出重点开向成熟制程，以解决当前的产能紧缺问题。

图 11: 主要晶圆代工厂资本开支变化



资料来源: Wind, 财信证券 (为直观反映变动趋势, 除台积电外均以次坐标轴表示)

图 12: 各主要晶圆厂 2021 年资本开支变化

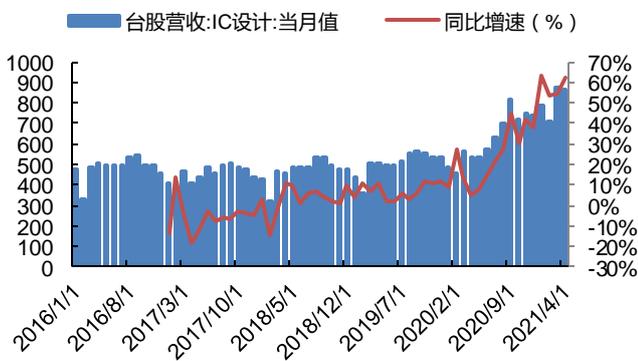


资料来源: Wind, 财信证券

3.3 台股月度经营数据延续景气, 部分涨价动能体现

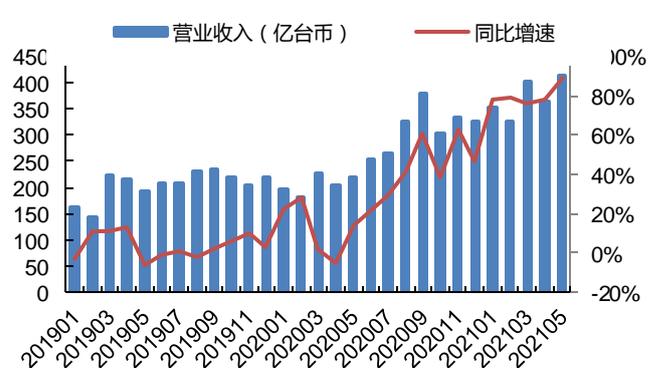
IC 设计类公司从 2020 年下半年开始进入景气区间, 月度合计营收由 500-600 亿区间快速上扬, 2021 年 5 月台股 IC 设计公司录得月度营收 863.28 亿新台币, 同比增长 62.81%。台股主要 IC 设计公司联发科、联咏和瑞昱均延续高景气, 均创下 2019 年以来的月度营收新高。

图 13: 台股 IC 设计月度营收变动与同比增速



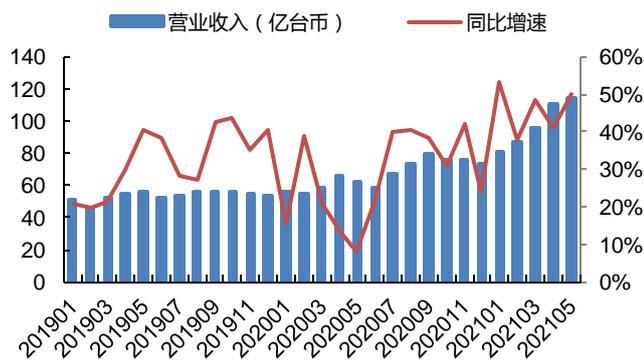
资料来源: Wind, 财信证券

图 14: 联发科月度营收变动与同比增速



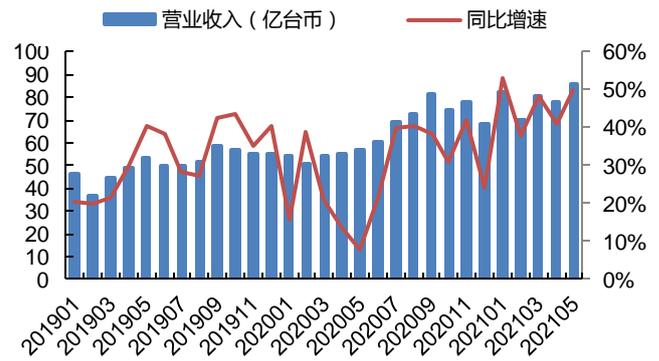
资料来源: Wind, 财信证券

图 15: 联咏月度营收变动与同比增速



资料来源: Wind, 财信证券

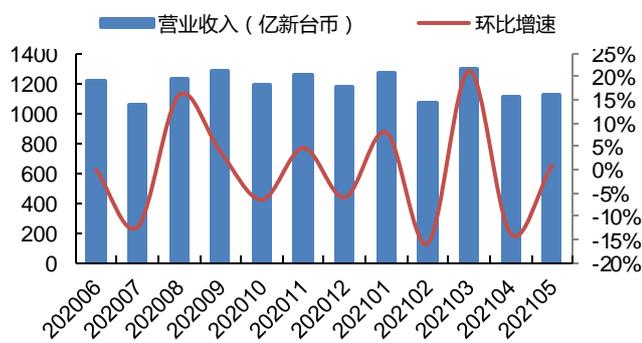
图 16: 瑞昱月度营收变动与同比增速



资料来源: Wind, 财信证券

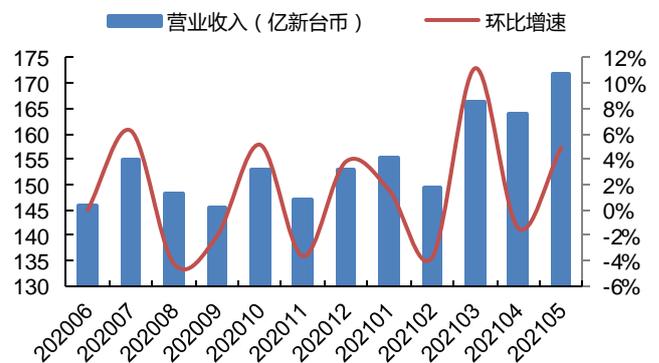
晶圆代工类上市公司中，成熟制程比重较高的企业率先受益于涨价。台积电 2021 年 5 月份录得营收 1123.60 亿新台币，环比增长 0.94%，但依然低于 3 月份月度营收数据，而以成熟制程为主的联电、力积电和旺宏环比增速均在 5% 左右，由于各代工厂产能利用率均接近满产，从 4 月和 5 月营收数据来看，成熟制程比重较高的企业率先受益于 4 月份涨价，考虑当前汽车、家电和工控等相关芯片需求依然旺盛，新建产能投放时间，涨价将持续。

图 17: 台积电月度营收变动与环比增速



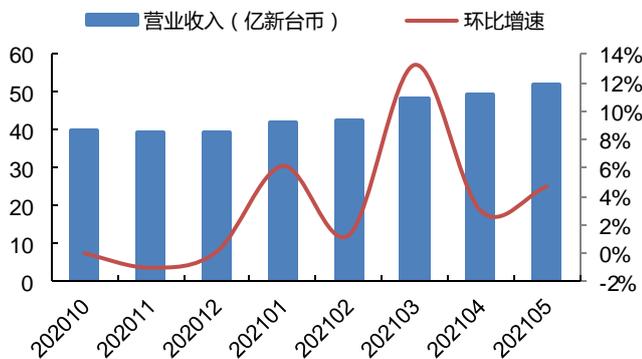
资料来源: Wind, 财信证券

图 18: 联电月度营收变动与环比增速



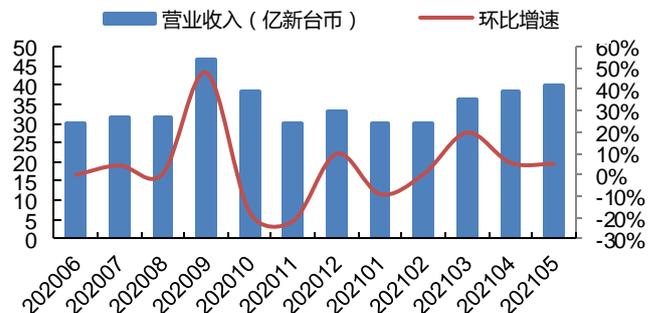
资料来源: Wind, 财信证券

图 19: 力积电月度营收变动与环比增速



资料来源: Wind, 财信证券

图 20: 旺宏月度营收变动与环比增速



资料来源: Wind, 财信证券

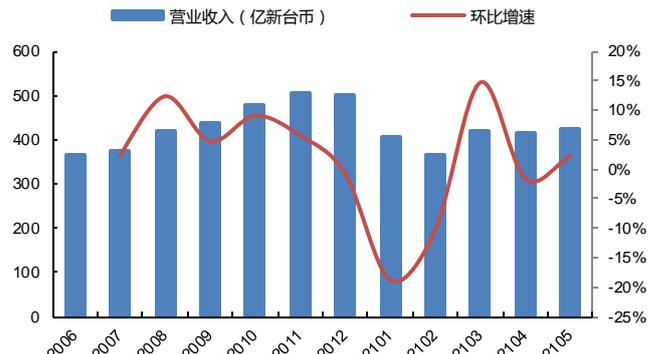
封测企业产能利用率维持高位，后续有望受益于价格传导。2021年4月台股IC封测整体实现营收475.91亿元，同比增长13.29%。2021年5月日月光投资实现营收422.67亿新台币，同比增长18.10%，环比增长2.26%。2021年整体封测厂商月度营收呈现逐月爬坡态势，其中DRAM/NAND/驱动IC等封装受益于下游需求旺盛以及积极备货影响订单表现强劲，力成等封测厂订单能见度看到3季度。目前日月光投控指出打线封装订单饱满，设备吃紧状况延续到年底，有消息预计日月光已与客户取消三季度封装价格的优惠并再度提高打线封装价格，调涨幅度约5%至10%。

图 21：台股 IC 封装测试月度营收变动与同比增速



资料来源：Wind，财信证券

图 22：日月光投控月度营收变动与同比增速



资料来源：Wind，财信证券

4 行业重点新闻

4.1 SEMI：2022 年全球半导体产业规模均值达 5700 亿美元，至 2022 年进入三年超级周期

近日 SEMI 中国区总裁在世界半导体大会上表示，半导体市场自 2019 年以后至 2022 年有望进入连续三年的超级景气周期，并根据收集到的各机构的预测，2022 年全球半导体产业规模均值达 5700 亿美金。FAB 厂的数量将大幅增加，未来新增 FAB 厂数量 38 个；全球半导体制造商将持续提高 8 英寸产能，月扩张产能约为 95 万片，增幅约 17%；从区域分布来看，扩张的产能主力来自于中国；受益于超级周期，2021 年半导体公司的资本支出将达到创纪录的水平，其中前三大半导体设备消费国分别为韩国（223 亿美元）、中国台湾（193 亿美元）和中国大陆（139 亿美元）。

信息来源：SEMI、世界半导体大会

4.2 刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议

国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议 5 月 14 日在北京召开。中

共中央政治局委员、国务院副总理、国家科技体制改革和创新体系建设领导小组组长刘鹤主持会议并讲话。会议指出必须坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，深刻理解科技创新在推动高质量发展、构建新发展格局中的关键作用。此外，会议还专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

信息来源：中国政府网

4.3 一季度十大晶圆代工厂商产值再创新高

根据集邦咨询数据显示，2021 年第一季前十大晶圆代工业者总产值突破单季历史新高，达 227.5 亿美元，季增 1%。2021Q1 受惠于多项终端应用需求增长，各项零部件备货强劲，晶圆代工产能自 2020 年起便供不应求，各厂纷纷调涨晶圆售价及调整产品组合以确保获利水平。展望第二季度，TrendForce 认为，晶圆代工仍将处于供不应求态势，平均销售单价亦持续上扬，有望推升第二季度各大业者营收表现，此外，车用芯片生产订单受各国关注，恐将扩大产能排挤效应。因此，TrendForce 预计第二季度十大晶圆代工业者总产值有望再次创单季新高，季增 1% 至 3%。

信息来源：集邦咨询

5 重点公司新闻

5.1 中芯国际（688981.SH）：推出股权激励计划，员工覆盖范围广

中芯国际（688981.SH）公告推出股权激励计划，授予的限制性股票总量不超过 7565.04 万股，激励对象不超过 4000 人，约占公司 2020 年底员工总数 17,354 人的 23.05%，包括激励计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中高级业务管理人员、技术与业务骨干人员。激励计划的授予价格（含预留授予）为 20 元/股。按照业绩考核办法，公司 2021-2024 年营收分别达到 295 亿元、314 亿元、336 亿元、360 亿元，分别增长 22%、6%、7%、7%，从此次方案看出，股权激励计划所定目标与授予价格相对较低，更偏奖励性质。21-24 年本次激励预计摊销费用分别为 5.6/10.6/5.1/2.5 亿元。

信息来源：公司公告

5.2 长电科技（600584.SH）：完成收购 ADI 新加坡测试工厂

长电科技（600584.SH）公布完成收购 ADI 新加坡测试工厂，该厂房的测试人员将于近期陆续转入长电科技的生产环境中。长电科技新加坡子公司总经理丘立坚先生表示此次收购的完成，不但是对长电科技在新加坡一流的测试制造和工程能力的一大认可，也反映了 ADI 对我们合作关系的强大信心和高度信任。我们期待着凭借强有力的合作伙伴关系，进一步扩大我们在新加坡的半导体业务。通过此次收购，长电科技在加强 ADI 合作伙伴关系的同时，在新加坡的测试业务得以持续扩展，全球化经营布局快速稳步前行。

信息来源：公司新闻

5.3 华润微（688396.SH）：拟与大基金共建 12 寸功率半导体晶圆生产线

华润微电子发布公告，宣布公司全资子公司华微控股拟与大基金等共同投建 12 寸功率半导体晶圆生产线项目，该项目计划投资 75.5 亿元。具体而言，华微控股拟与大基金及重庆西永微电子产业园区开发有限公司，共同签署《润西微电子(重庆)有限公司投资协议》，发起设立润西微电子(重庆)有限公司，注册资本拟为 50 亿元，由项目公司投资建设 12 寸功率半导体晶圆生产线项目，项目计划投资 75.5 亿元。其中，华微控股以自有资金出资 9.5 亿元，出资完成后占项目公司注册资本的 19%。

信息来源：公司公告

5.4 士兰微（600460.SH）：拟 12 英寸高压集成电路和功率器件芯片

士兰微发布公告，拟 20 亿元投建“新增年产 24 万片 12 英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”，实施周期为 2 年。士兰微公告指出，当前集成电路芯片及功率器件市场面临良好的发展机遇，士兰集科很有必要在完成第一期投资 50 亿元的基础上，进一步增加投入，尽快扩大产能。新增扩产项目已于 2021 年 5 月 11 日取得了《厦门市企业投资项目备案证明》。

信息来源：公司公告

6 风险提示

贸易摩擦加剧，需求不及预期，国产替代放缓。

投资评级系统说明

以报告发布日后的 6—12 个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。

类别	投资评级	评级说明
股票投资评级	推荐	投资收益率超越沪深 300 指数 15% 以上
	谨慎推荐	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为 5%—15%
	中性	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为-10%—5%
	回避	投资收益率落后沪深 300 指数 10% 以上
行业投资评级	领先大市	行业指数涨跌幅超越沪深 300 指数 5% 以上
	同步大市	行业指数涨跌幅相对沪深 300 指数变动幅度为-5%—5%
	落后大市	行业指数涨跌幅落后沪深 300 指数 5% 以上

免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，作者具有中国证券业协会注册分析师执业资格或相当的专业胜任能力。

本报告仅供财信证券有限责任公司客户及员工使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发送，概不构成任何广告。

本报告信息来源于公开资料，本公司对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本公司对已发报告无更新义务，若报告中所含信息发生变化，本公司可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司及本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此作出的任何投资决策与本公司及本公司员工或者关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人（包括本公司客户及员工）不得以任何形式复制、发表、引用或传播。

本报告由财信证券研究发展中心对许可范围内人员统一发送，任何人不得在公众媒体或其它渠道对外公开发布。任何机构和个人（包括本公司内部客户及员工）对外散发本报告的，则该机构和个人独自为此发送行为负责，本公司保留对该机构和个人追究相应法律责任的权利。

财信证券研究发展中心

网址：www.cfzq.com

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层

邮编：410005

电话：0731-84403360

传真：0731-84403438